



全世界领先元器件制造商的选择

印刷叠层一体机

PAL - 系列



- 高层数堆叠应用
- 低成本，高效率
- 印刷精度高，适用于最小的元器件应用
- 可使用带载带膜带或不带载带膜带
- 完美的载带分离技术确保高产品质量
- 可设计满足客户任何需求

适合高层数大批量生产应用

基本特点:

PAL 系列是高度集成的印叠一体化技术设备，可自动加载和卸载载板，在水平轨道上同一时间可同时传送100个载板。从卷带上将膜带 载成膜片并压到叠层上，然后再精准印刷电极和干燥电极，使用创新型系统从载带上分离陶瓷带。以此循环，直至完成所需层数和电极 的累计。压制产生完全平坦和平滑的堆叠顶部表面，非常适合低电极沉积应用。

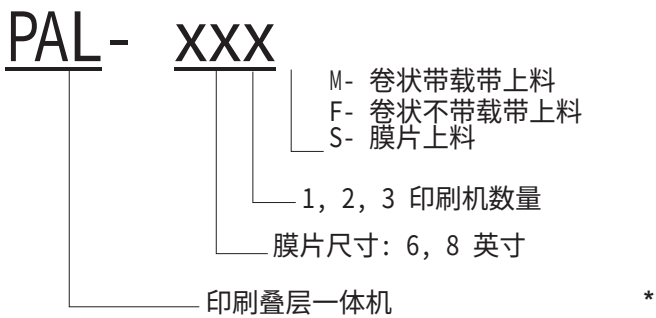
优越的点定位精度非常适合最小片式元器件（即0402）应用。高效率，高速，循环周期短（低至5秒印刷循环时间包含载板传送时间）

选配:

- 料匣上料系统
- 可安装多达 4 个以上卷状上料器
- 自动供应浆料
- 自动丝印效果检测
- 载板降温系统
- 定制化满足特殊需求
- 可安装多达 2 个以上印刷头

技术规格			
丝印/压台面积	6 x 6 英寸, (8 x 8英寸)	刮刀	带有扩展栏选项的拖动或菱形类型
清洁空气	轨道完全覆盖适用洁净室应用	刮刀速度	50-250 mm/sec. 或 2-10 英寸/sec.
载板数量	1-100 块	叠压台压力	达 350 kN或76,000 lbf (选配 440 kN 或95,000 lbf)
载板传送	高速皮带	叠压台	温度达 120 ° C
循环时间	最小 5 sec. (3 sec. 压合时间)	干燥炉	循环热风达 100 ° C

如何选型: *



* 选配或者其它需求需要单独区分开



Grajski trg 15, 360 Zuzemberk, Slovenija
T +386 7 3885 200
F +386 7 3885 203
info@keko-equipment.com
www.keko-equipment.com